

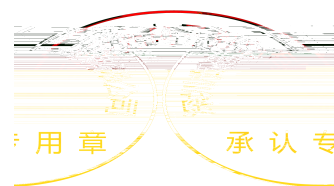
# 产品 书



R&D 发

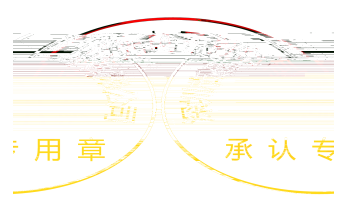
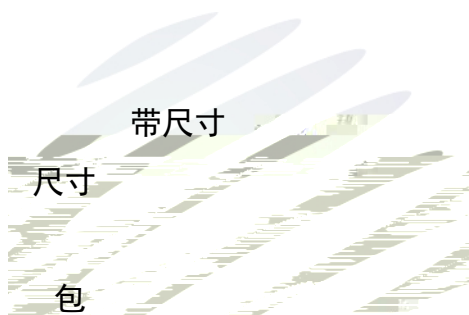


产供



# 录

产品介		3
产品描		3
产品 征		3
产品应		3
封 尺寸		4
产品参数		5
典型光学 性		7
产品包		11
包		11
2.1.5	带尺寸	
	卷 尺寸	
	包	12
包		13
	信 性 及 件	13
	失效判定 准	14
	回	15
	回	15
产品使 意事		17
产品使 意事		17



## 产品介绍

### 产品描述

产品为光，光封形成，产品尺寸：。

### 产品特征

小发光度

于所 SMT 和接工

Level 13

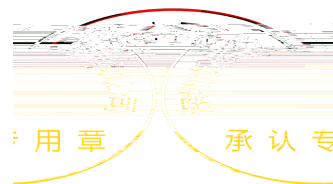
RoHS

### 产品应用

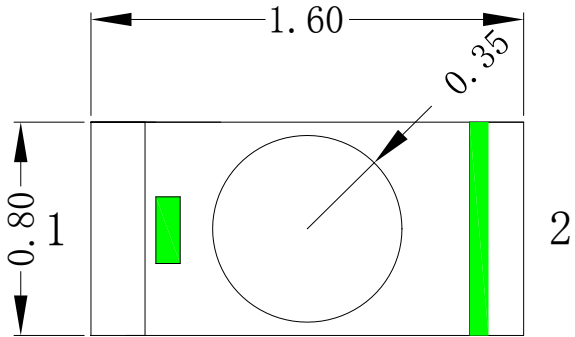
光学指

开关和志，器

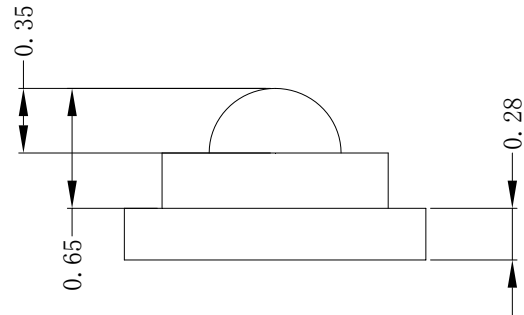
其他应



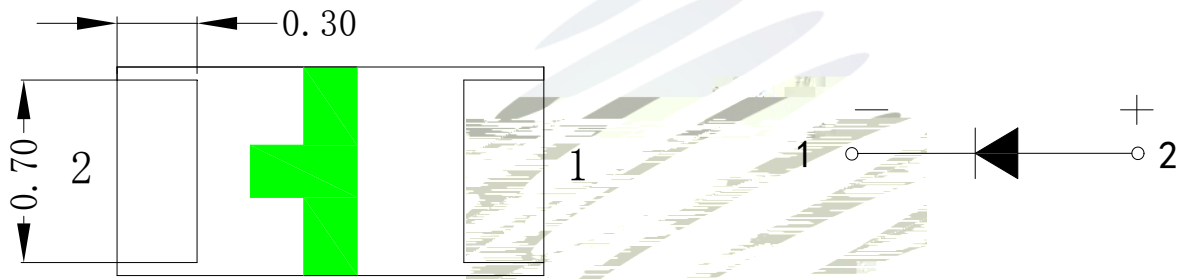
### 封 尺 寸



图

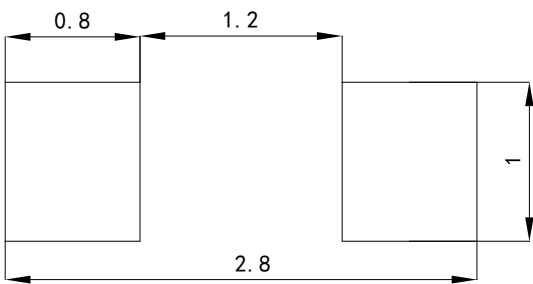


侧 图



图

性

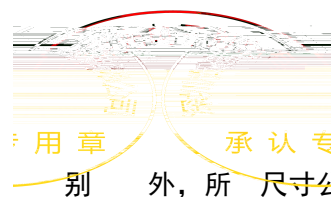


推

备 ：

1. 所 尺 寸 单 位 为

2. ±



别 外, 所 尺 寸 公 差 为 ±0.2 。

## 产品参数

性与光学 性

件 号	小 值		单 位
	(典型值)	(大 值)	
半 宽			
向 压			
主			
发光强度			
发 光 度			

图 0

备 为 分 件。

对 大值

(参数)

(号)

(值)

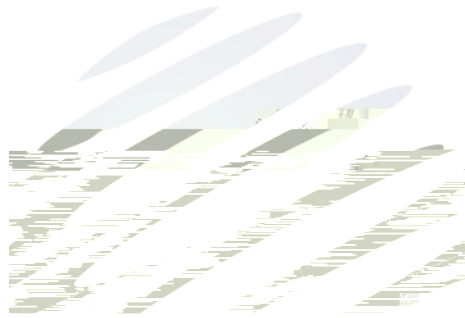
(单位)

(功 )

(向 )

(冲峰值 )

( )



备 :

宽0.1ms,占 1/10.

以上所 压 差 ±0.1V.

以主 差±2nm.

上 发光强度 允 公差为±10%.

使

功 不 定 大值。

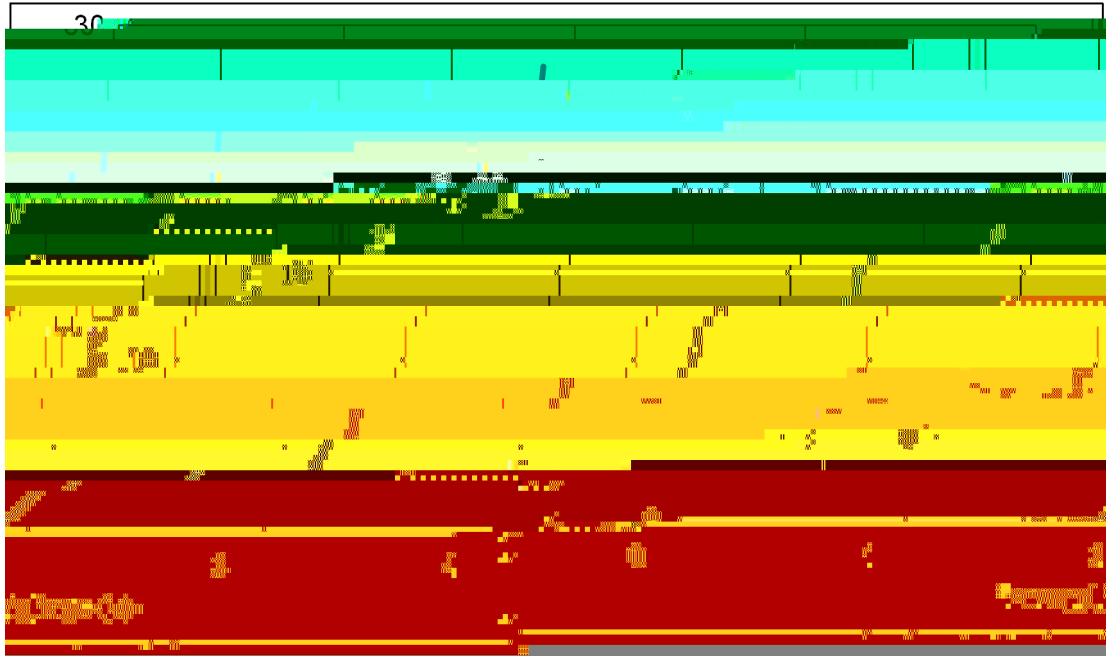
所 基于 丰

准 平台。

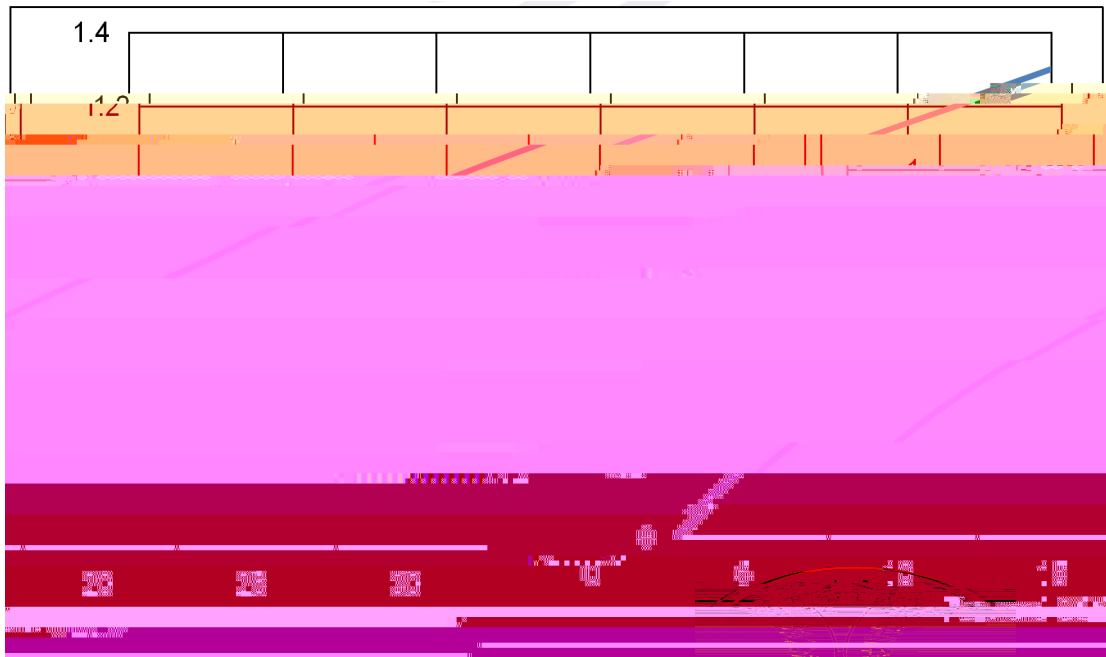
. LED使 大 据散

件 定, 不 大值。

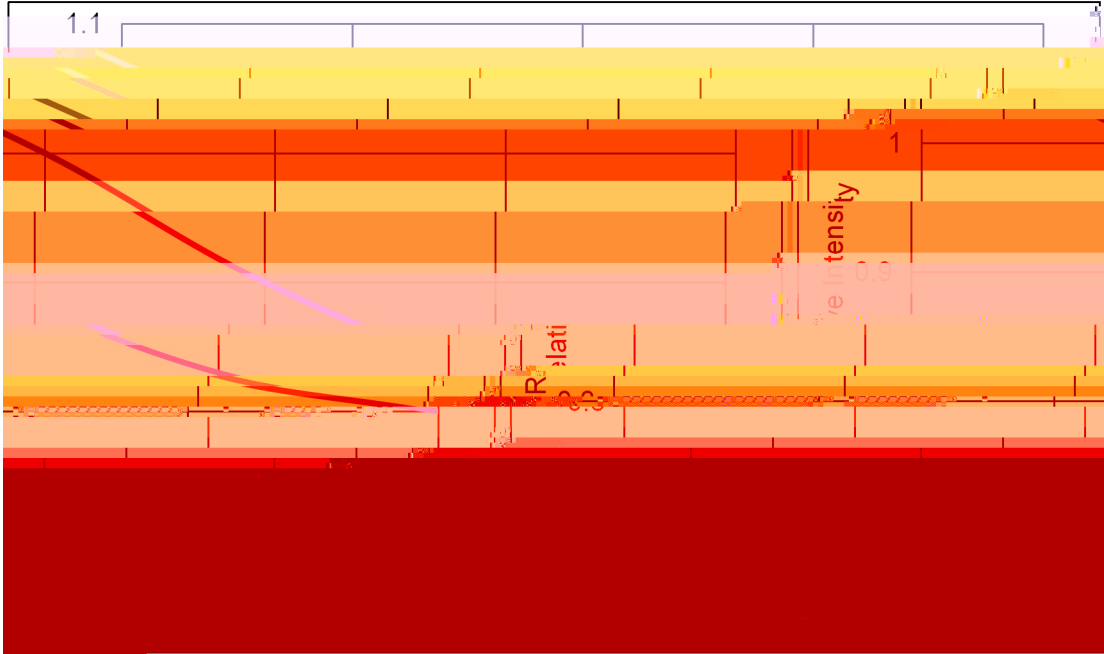
# 典型光学性能



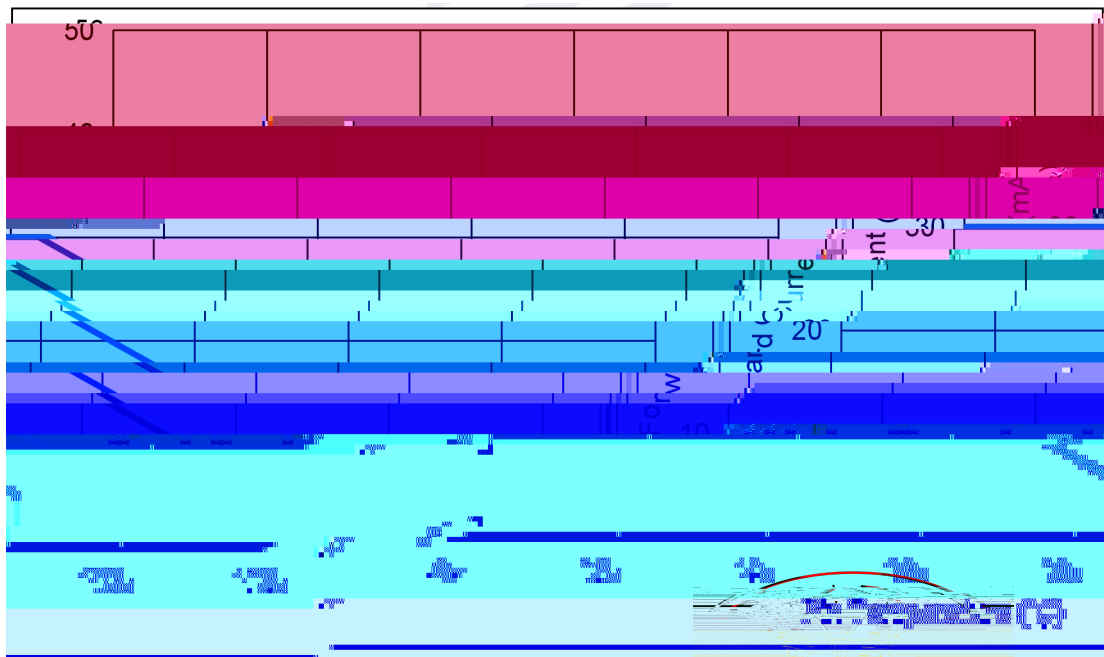
伏安特性



用章 承认专  
向 与 对光强 性

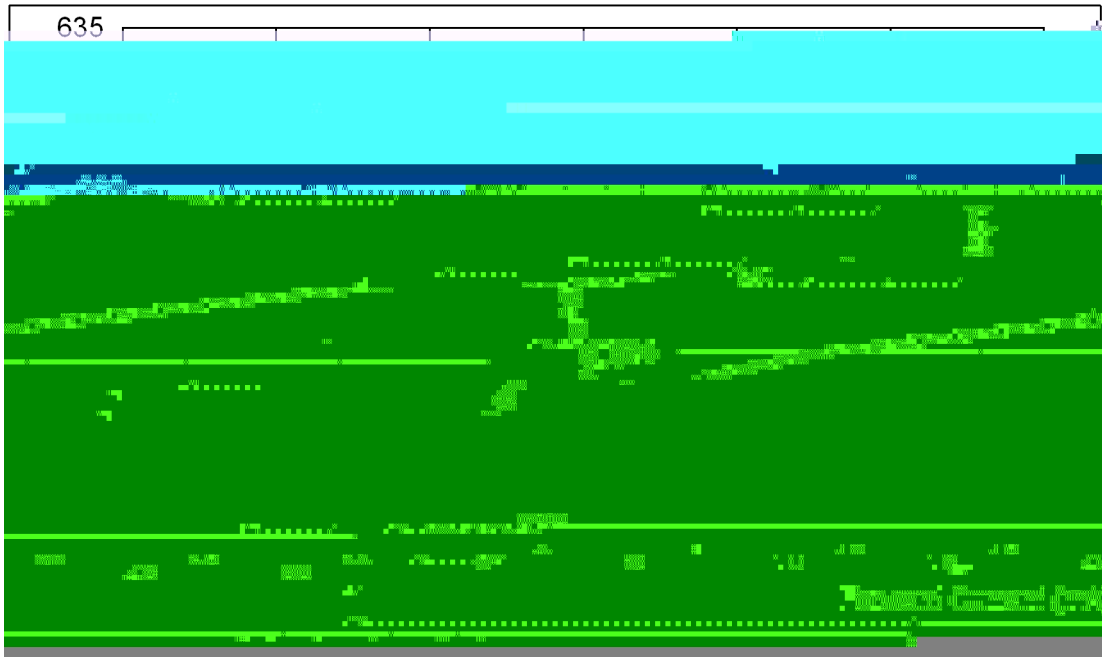


引 度与 对光强 性

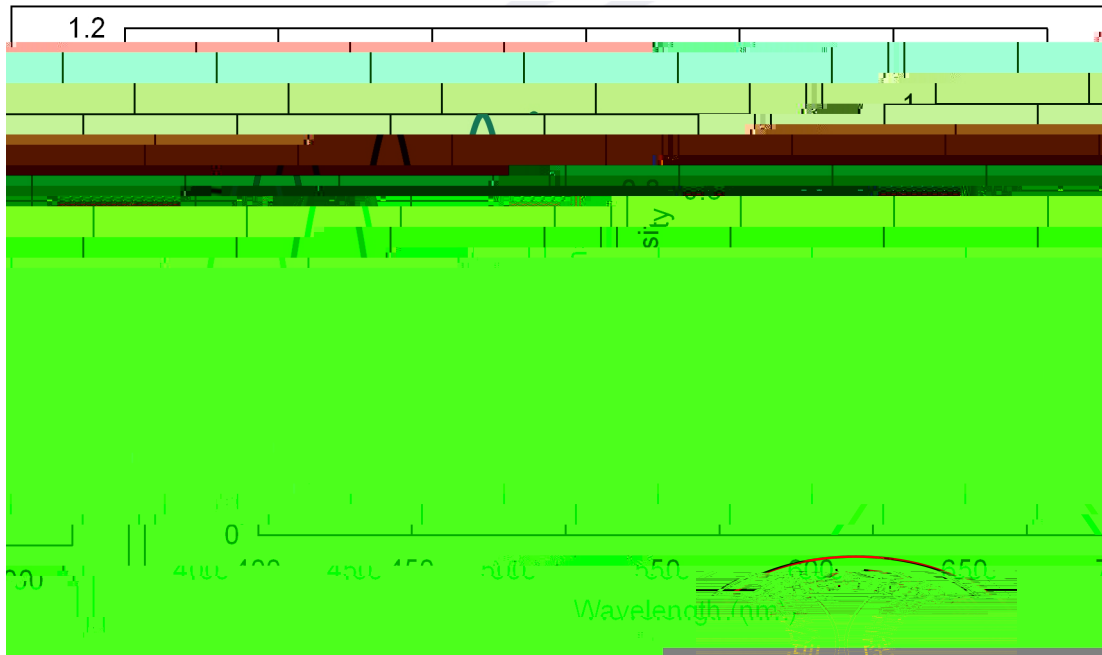


引 用 度 与 承 认 专 性

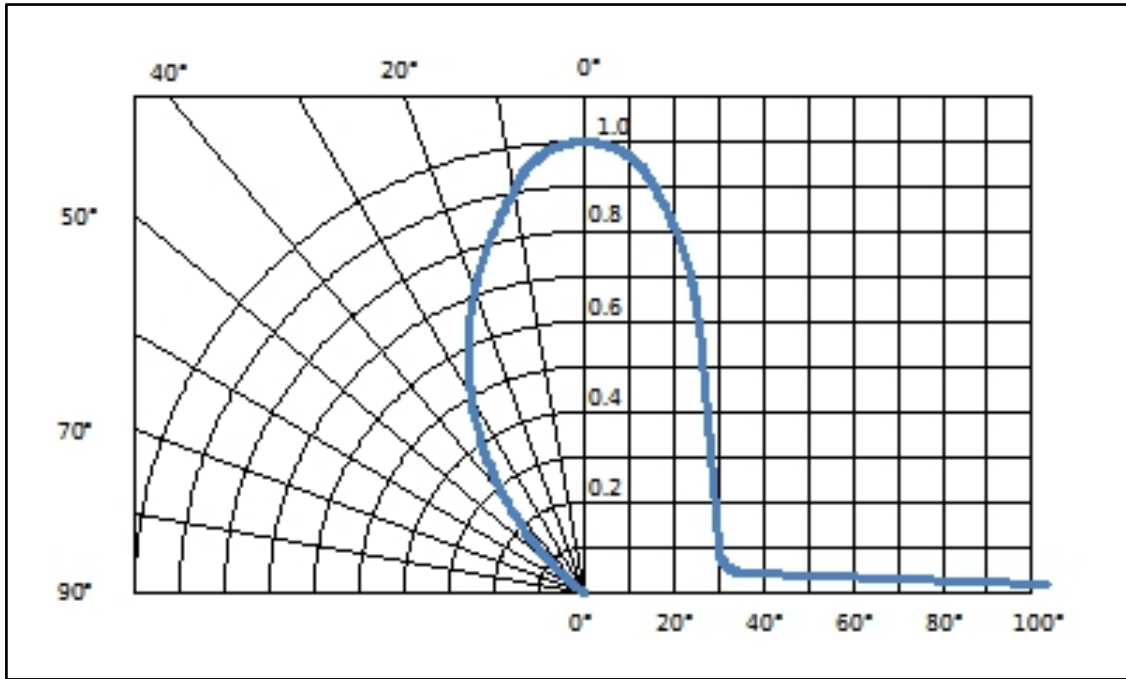




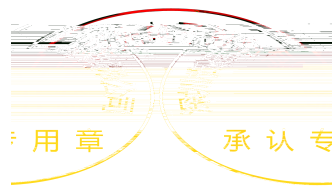
向 与主 关

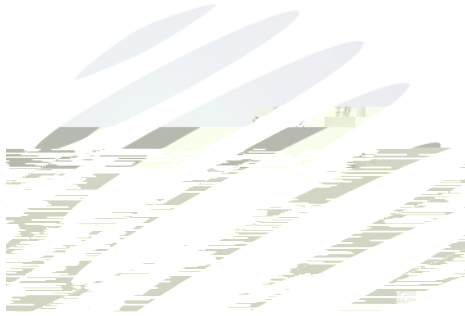


用章 承认专  
对光强与 关





射 性





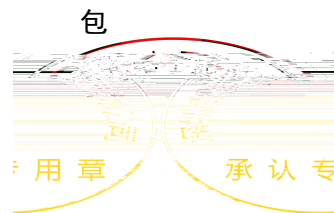
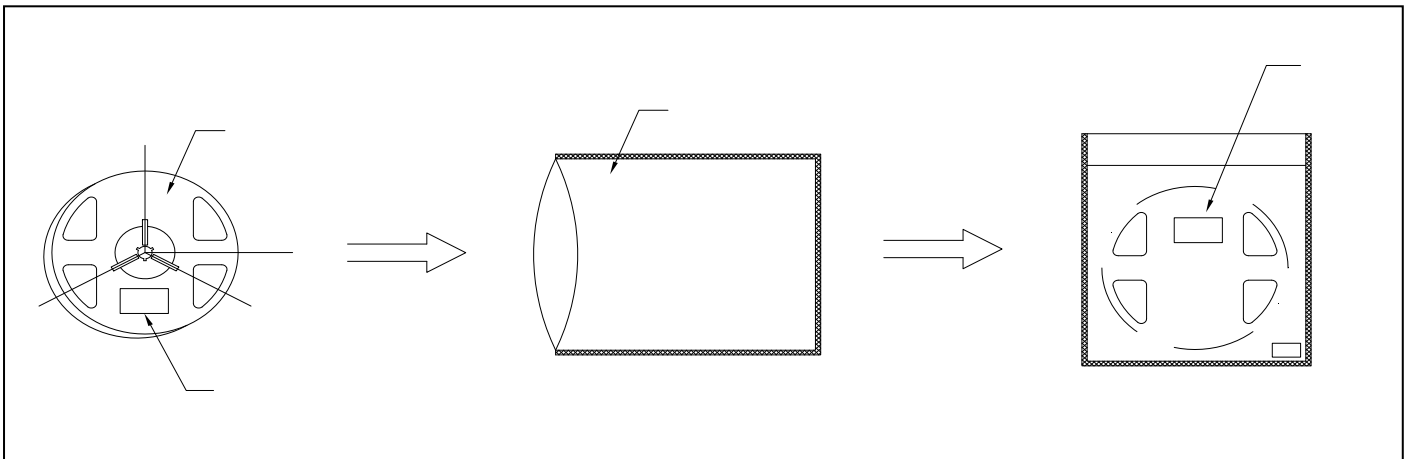
PART NO:  
 SPEC NO:  
 LOT NO:  
 BIN CODE:  
 IV:  
 VF:  
 WLD:  
 Qty:  
 Date:

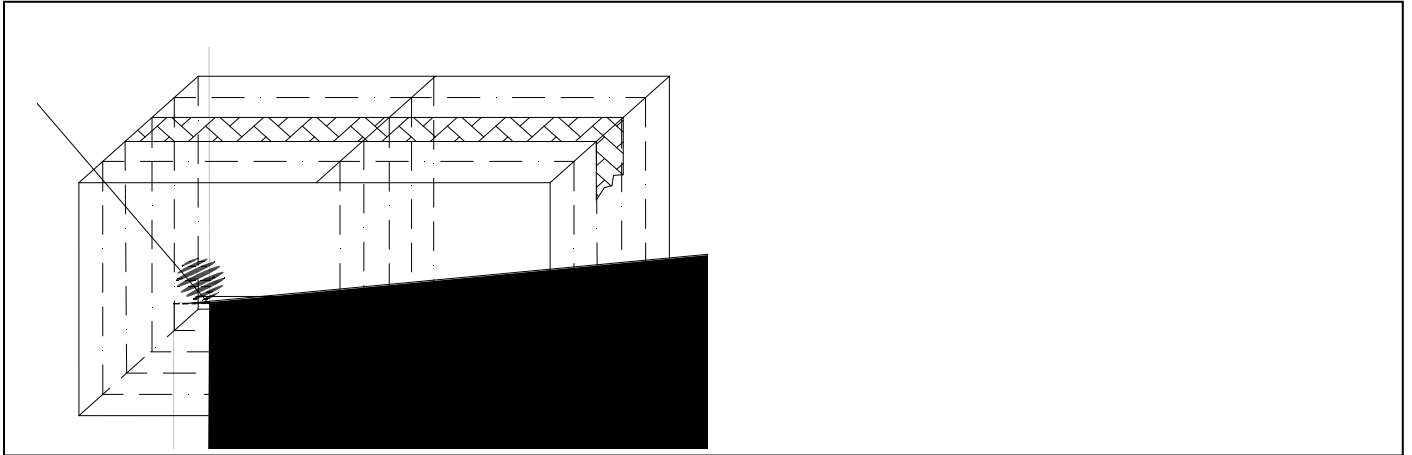
参数
品名
批号
参数代
光
区
向压
代
数
产



包



包



包  
信 性 及 件  
信 性 及 件

	参 准	件	数	接收 拒收
回		°C		
度循		°C °C		
冷 冲击		°C °C		
保存		°C		
低 保存		°C		
常		°C		

## 失效判定 准

失效判定 准

	号	件	判定 准	
			小	大
向 压				
光				

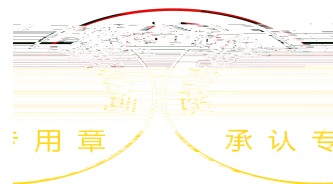
备 ：

上

下

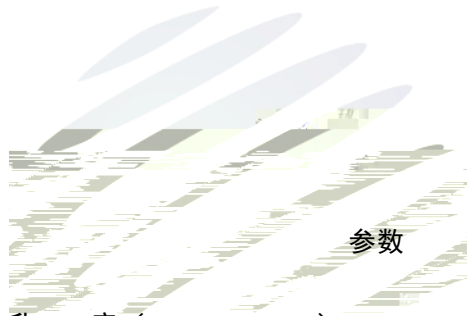
以上可 性 基于 丰 实 平台单 / LED在 好散 件  
下 。客户 将LED应 于串、并 ， 估 、 压分 、 散 。

以上技 数据仅为产品 典型值，只作为参 ，不作为任何应 件及应 方式 保 。



回

回



平均升 度 ( )

: 低 度

: 度

: ( )

持 : 度

持 :

峰值 分 度

峰值分 度: ( ) 多

备：

回 数不可以 两 ，两 回 如 24小 ，LED可 于吸 损坏。

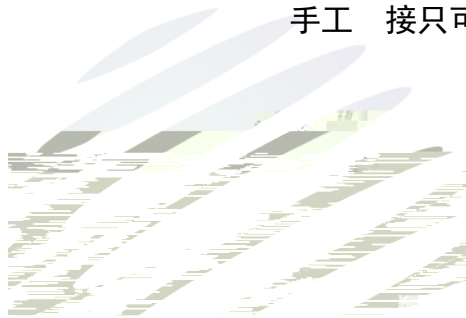
当 接 ，不 在 料受 力压 体 。

### 接

.当手工 接 ， 度必 小于300°C， 不可 3 。

手工 接只可 接一 。

### 修

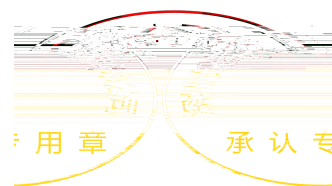


回 后不应 修复，当必 修复 ，必 使 双头 ， 且事先应 方式会不 会损坏LED 性。

### 意事

不 接在弯 PCB 上， 接之后，也不 弯折 。

对 料实加外力，也不 动，回 后，不 回 之后冷却 中，不 剧冷却 方式。





## 产品使用注意事项

### 产品使用注意事项

工作环境及与LED材料中元素及化学成分不可超过100PPM。只一个建设，不作任何品质担保。

为了预防异物进入LED内部造成LED损伤，所处环境及所套件，单一元素含量小于900PPM，单一元素含量小于900PPM，元素与元素总含量必小于1500PPM。只一个建设，不作任何品质担保。

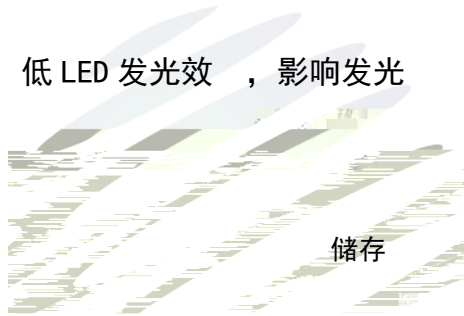
应套件中挥发性物质会进入到LED内部，在生产光子及器件下，会导致LED变质，造成严重光衰，提前了套件寿命。免产这些。丰反对使任何对LED器件性能或可靠性有害的物质，不这些物质已实施了仅仅危害。对特定使用环境，丰建对所选材料和兼容性。在LED时候，不使用产生挥发性物质。

用章 承认专

LED  
 不定大值，同，使保护，否则，微小压变化将会引大  
 变化，可导产品损。必保只在开启或关候出向压变化，不  
 加反压，否则会损坏LED。

度改变改变，度升会低LED发光效，影响发光，所以在应充分散  
 。容因为发和境

储存

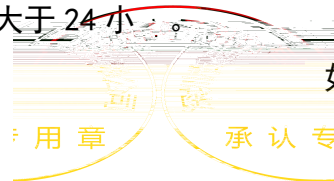


储存

		度	度	
储存	拆包前			一年内
	拆包后			小
				大于 小

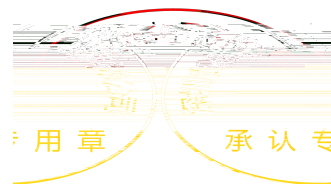
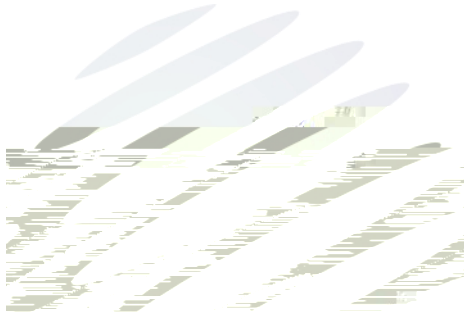
如干剂或包失效，或产品不合以上  
 效储存件，拆包后，件：60±5°C，大于24小。

损，售人员协助处。如包或

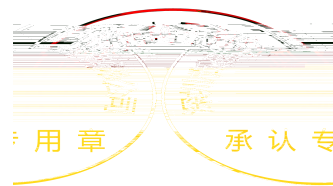


像其他 半导体 子器件一 ， LED 对 击 常敏感，  
做好 护。

其它 意事 参 丰  
关 料。







产品 书以中 文方式书写， 冲 以中文 为准。